

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	信金投资荣子光; 运舟资本王岩; 山西证券邓周宇; 华商基金高兵; 中信证券王凯旋; 附加值投资周浩锋、程晓鑫; 景元天成邓志峰; 中邮证券蔡明子; 财通资管郭琪; 有米资管周平、陈绍杰; 天安人寿李勇刚; 华福证券杨钟; 瑞银资管王海明; 华鑫证券何鹏程; 太平洋证券谭紫媚、任欣平等 20 名投资者参会。	
时间	2024 年 6 月 19 日 15:00-17:00	
地点	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 26 号 (柏明胜园区)	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘力; 投资者关系总监许益群; 证券事务代表程筱玥。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、柏明胜园区参观及介绍</p> <p>参观园区: 昌红科技投资者关系总监许益群、董事会秘书刘力带领投资者参观浙江柏明胜及鼎龙蔚柏工厂。</p> <p>基本介绍: 昌红科技在逆全球化的风口中获得了与医疗巨头客户的合作机遇, 为把握机会做了充分的准备, 包括内部人才梯队的建设、加快产能落地速度、产品技术的突破、销售体系的完善等方面。</p> <p>业务布局方面: 公司医疗板块在 2023 年、2024 年期间切入了糖尿病领域等小型医疗器械生产及组装, 实现了 CGM 零部件及产品装配的全流程生产; 在分子诊断方面储备先进的微流控技术; 具备医疗试剂包装材料的生产能力; 对胰岛素泵类产品进行布局; 开始在慢性病领域产品布局; 6 月 4 日, 公司与费森尤斯签署战略合作协议, 标志着公司将加大在血液透析耗材领域产品业务的发展。</p> <p>半导体板块在 2023 年、2024 年期间完成了生产车间的装修, 获得 ISO9001 认证证书, 已具备量产条件, 产品处于客户验证过程中。</p>	

	<p>公司将瞄准高端化、数字化、全球化方向。坚持以“智能制造”为发展重点，聚焦主业核心技术研发，探索多领域发展，丰富产品链种类，增强企业核心竞争力。夯实办公自动化（OA）领域基石业务，加速医疗耗材项目落地投产，抓住医疗器械 CDMO 行业发展，积极探索小型医疗器械组装领域，加快半导体领域产品开发，全速发展三大业务驱动支柱。</p> <p>二、提问与交流</p> <p>1、公司是什么契机进入半导体领域？ 回复：我国半导体行业受限于国际政策，行业相关耗材产品供应受限，为实现半导体产业链自主可控、国内半导体企业突破进口制裁限制的紧迫性的因素。昌红科技凭借自身优势技术和鼎龙股份强强联手，共同设立鼎龙蔚柏，针对半导体行业稀缺的塑料耗材产品进行开发。</p> <p>2、鼎龙蔚柏对于原材料供应稳定是否有做技术储备和研究？ 回复：鼎龙蔚柏在 4 月 24 日国际橡塑展上与中国石化达成战略合作关系，响应国家材料供应链国产化要求，合作开发国产原料，与现有产品验证同步进行，籍此保障原材料供应稳定。</p> <p>3、公司医疗产品 2023 年毛利率高于 2022 年的原因？ 回复：公司 2023 年医疗产品毛利率上升的主要原因在于新增医疗产品、部分客户的医疗产品及定制自动化生产线的售价较高，同时公司加强内部成本管控进而降低材料消耗及人工成本，单位毛利较高，毛利增加，进而拉高了医疗产品整体毛利率。</p> <p>4、昌红医疗板块客户为什么要购买产线装备？ 回复：医疗板块客户购买生产线装备主要是为了保障产线的稳定性，昌红为医疗客户定制非标自动化生产线能满足产品稳定的安全供应，其次可以对生产产品有更高的品质保证，保障客户自身的供应链安全。</p> <p>5、公司可转债是否有下修转股价格的计划？ 回复：公司可转债的到期日为 2027 年，距离到期还有两年多的时间。公司将根据自身的发展、订单情况、市场情况等因素进行判断。未来股价受多种因素影响，包括公司业绩和市场环境，如有修改计划请各位投资者关注公司的公告。</p> <p>6、昌红科技半导体业务的进展及客户验证情况？ 回复：昌红科技的半导体业务目前仍处于客户验证阶段，尚未结束。鼎龙蔚柏在研产品 7 个，且 1 个产品已经通过验证，1 个产品在 3 家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段，1 个产品也在加速验证过程中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 20 日